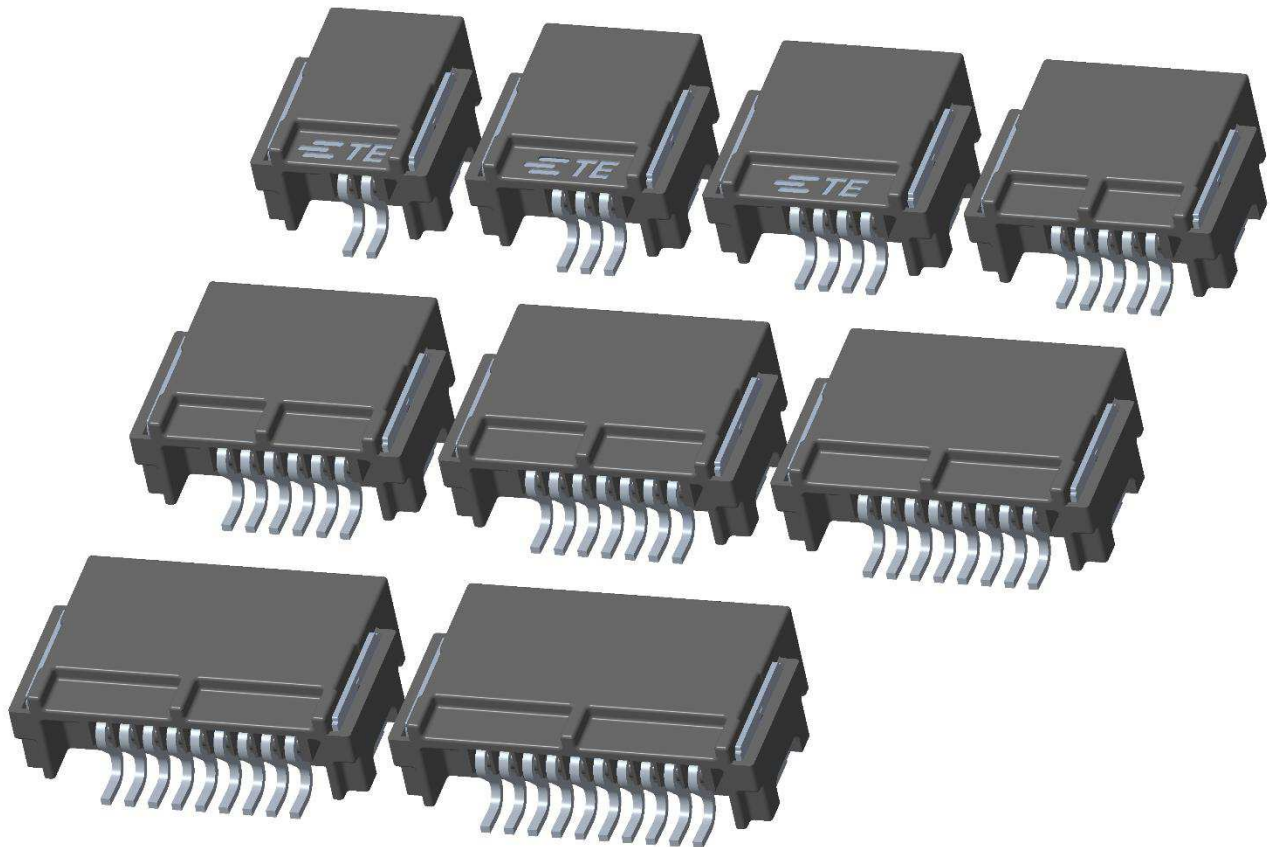

Class 1

PicoMQS SMD 90° Header SERIES

PicoMQS SMD 90° Stifflisten Serie / Familie



Inhalt

1. Scope / Anwendungsbereich	3
1.1. Content / Inhalt.....	3
1.2. Qualification / Qualifikation	3
2. Applicable documents / Anwendbare Unterlagen	3
2.1. TE Documents / TE Dokumente	4
a. Customer drawings / Kundenzeichnungen	4
b. Specifications / Spezifikationen	4
c. Other documents / Allgemeine Unterlagen.....	4
3. Requirements / Anforderungen.....	5
3.1. TE Design and Construction / Entwurf und Konstruktion.....	5
3.2. Materials / Werkstoffe	5
3.3. Ratings / Leistungsmerkmale	6
3.4. Performance and Test Description / Leistungsmerkmale und Testbeschreibung.....	6
3.5. Test Requirements and Procedures Summary / Anforderungen und Prüfungen	8
3.6. Qualification and Requalification Tests of PicoMQS contacts / Qualifikations- und Re-Qualifikationsprüfungen der PicoMQS Kontakte.....	12
4. Quality assurance provisions / Qualitätssicherungsmaßnahmen	12
4.1. Qualification Testing / Qualifikationsprüfung	12
a. Sample Selection / Auswahl der Prüflinge	12
b. Test Sequence / Prüfgruppen	12
4.2. Requalification Testing / Re-Qualifikationsprüfung	12
4.3. Acceptance / Abnahme	13
4.4. Quality Conformance Inspection / Prüfung der Qualitätskonformität	13
5. Addendum / Anhang.....	14

1. SCOPE / ANWENDUNGSBEREICH

1.1. Content / Inhalt

This specification covers the performance, tests and quality requirements of the PicoMQS SMD Header series according to TE-standard.

The current variants are the 2-10pos. versions. Order-No. see drawings.

Deviations according to the requirements of the LV214 2010-04 (MBN 10384 2010-11; VW 75174 2010-04; GS 95006-7-1 2010-05): comes from the size of the contact system PicoMQS. The current LV214 only covers Systems > 0,63mm.

Diese Spezifikation beschreibt die Eigenschaften, Tests und Qualitätsanforderungen der PicoMQS SMD Stiftleisten Serie nach TE-Standard.

Die aktuellen Varianten sind die 2-10pol Versionen. Bestell-Nr. siehe Zeichnungen.

Abweichungen der Anforderungen zur LV214 2010-04 (MBN 10384 2010-11; VW 75174 2010-04; GS 95006-7-1 2010-05): kommen durch die Größe des Kontaktsystems PicoMQS. Die aktuelle LV214: 2010-04 beinhaltet nur Systeme ab 0,63mm.

1.2. Qualification / Qualifikation

When tests are performed, the following specifications and standards should be used. All inspections must be performed using the applicable inspection plan and product drawing.

Bei der Prüfung der genannten Produkte sind die nachfolgenden Richtlinien und Normen zu verwenden. Alle Prüfungen sind nach den zugehörigen Prüfplänen und Produktzeichnungen durchzuführen.

2. APPLICABLE DOCUMENTS / ANWENDBARE UNTERLAGEN

The following documents form are part of this specification to the extent specified herein. In the events of conflict between the requirements of this specification and the product drawing or of conflict between the requirements of this specification and the referenced documents, this specification shall take precedence. For the listed documents is valid the specification at the date of the first release of this specification.

Die nachfolgend genannten Unterlagen, sofern darauf verwiesen wird, sind Teil dieser Spezifikation. Im Falle des Widerspruches zwischen dieser Spezifikation und der Produktzeichnung oder des Widerspruches zwischen dieser Spezifikation und den aufgeführten Unterlagen hat diese Spezifikation Vorrang. Für die aufgeführten Unterlagen gilt jeweils der zum Zeitpunkt der Erstfreigabe dieser Spezifikation veröffentlichte Ausgabestand.

2.1. TE Documents / TE Dokumente

a. Customer drawings / Kundenzeichnungen

2Pos PicoMQS SMD Header	PN 2339202-2	<p style="text-align: center;">Customer Drawing 2304165</p> <p style="text-align: center;">Kundenzeichnung 2304165</p>
3Pos PicoMQS SMD Header	PN 2339203-3	
4Pos PicoMQS SMD Header	PN 2339204-4	
5Pos PicoMQS SMD Header	PN 2323101-5	
6Pos PicoMQS SMD Header	PN 2339206-6	
7Pos PicoMQS SMD Header	PN 2323102-7	
8Pos PicoMQS SMD Header	PN 2323103-8	
9Pos PicoMQS SMD Header	PN 2339209-9	
10Pos PicoMQS SMD Header	PN 1-2339210-0	

b. Specifications / Spezifikationen

<p style="text-align: center;">General Requirements for Test Specifications Generelle Anforderungen für die Testdurchführungen</p>	SS 109-1
<p style="text-align: center;">Component Heat Resistance to Lead-Free Reflow Soldering Bauteil Wärmebeständigkeit beim bleifreien Reflow-Löten</p>	TEC-109-201
<p style="text-align: center;">Product-Specification PicoMQS contacts Produkt-Spezifikation PicoMQS Kontakte</p>	SS 108-94545
<p style="text-align: center;">Application-Specification PicoMQS contacts Verarbeitungs-Spezifikation PicoMQS Kontakte</p>	SS 114-94424
<p style="text-align: center;">Product-Specification PicoMQS receptacle Housing series 1-Row Produkt-Spezifikation PicoMQS Buchsengehäuse Serie / Familie 1-reihig</p>	SS 108-94648
<p style="text-align: center;">Application-Specification PicoMQS receptacle Housing series 1-Row Verarbeitungs-Spezifikation PicoMQS Buchsengehäuse Serie / Familie 1-reihig</p>	SS 114-94520

c. Other documents / Allgemeine Unterlagen

<p style="text-align: center;">Interface for 2-10pos Schnittstelle für 2-10pol</p>	208-18038
---	-----------

3. REQUIREMENTS / ANFORDERUNGEN

3.1. TE Design and Construction / Entwurf und Konstruktion

Product shall be of the design, construction and physical dimensions specified on the applicable production drawing.

Das Produkt muss in seiner Ausführung und seinen physikalischen Abmessungen der Produktionszeichnung entsprechen.

3.2. Materials / Werkstoffe

Descriptions for material see in production drawings.

Angaben hierzu sind den Zeichnungsunterlagen zu entnehmen.

3.3. Ratings / Leistungsmerkmale

For electrical and mechanical ratings of the PicoMQS contact system see 108-94545.

Die elektrischen und mechanischen Kennwerte des PicoMQS Kontakt Systems sind in der Spezifikation 108-94545 nachzuschlagen.

Technical Data – Performance Guide

Technische Daten – Leistungseckwerte

Maximum Current Carrying / Maximale Strombelastbarkeit	See derating curves in addendum and in product specification of the contact system. Depending on max. current carrying capability of used wire and on base material of the used mating part. Siehe Derating-kurven im Anhang und in der Produktspezifikation des Kontaktsystems. Abhängig von max. Strombelastbarkeit der verwendeten Leitung und vom Basismaterial des verwendeten Gegensteckers
Durability cycles acc. to contact specification / Steckhäufigkeit nach der Kontaktspezifikation	10 (Sn)
Temperature Range / Gesamttemperaturbereich	-40°C ... 130°C (Sn)
Operating Voltage / Nennspannung	≤ 12 V d.c. ≤ 12 V d.c.
Flammability Class / Entflammbarkeitsklasse	UL94-HB

3.4. Performance and Test Description / Leistungsmerkmale und Testbeschreibung

The product is designed to meet the electrical, mechanical and environmental performance requirements specified in Para. 3.5. All tests are performed at ambient environmental conditions per LV214 (MBN 10384 2010-11; VW 75174 2010-04; GS 95006-7-1 2010-05) unless otherwise specified.

Das Produkt erfüllt die in Abschnitt 3.5 aufgeführten elektrischen, mechanischen und klimatischen Anforderungen. Soweit nicht anders spezifiziert, sind alle Prüfungen unter den in der LV214 (MBN 10384 2010-11; VW 75174 2010-04; GS 95006-7-1 2010-05) genannten Umweltbedingungen durchgeführt.

Standards

Normen

Plug connectors - Testings / Steckverbinder – Prüfungen	GS 95006-7-1 2010-05 MBN 10384 2010-11 VW 75174 2020-04
Connectors for electronic equipment – Tests and measurements Part 1-1: General examination – Test 1a: Visual examination Steckverbinder für elektronische Einrichtungen – Mess- und Prüfverfahren Teil 1-1: Allgemeine Untersuchungen – Prüfung 1a: Sichtprüfung	DIN EN 60512-1-1 2003-01
Connectors for electronic equipment – Tests and measurements Part 3-1: Insulation tests – Tests 3a: Insulation resistance Steckverbinder für elektronische Einrichtungen – Mess- und Prüfverfahren Teil 3-1: Prüfungen der Isolation – Prüfung 3a: Isolationswiderstand	DIN EN 60512-3-1 2003-01
Connectors for electronic equipment – Tests and measurements Part 13-5: Mechanical operation tests – Test 13e: Polarization and keying method Steckverbinder für elektronische Einrichtungen – Mess- und Prüfverfahren Teil 13-5: Prüfungen der mechanischen Bedienbarkeit – Prüfung 13e: Polarisierung und Kodierung	DIN EN 60512-13-5 2006-11
Connectors for electronic equipment – Tests and measurements Part 15-6: Connector tests (mechanical) – Test 15f: Effectiveness of connector coupling devices Steckverbinder für elektronische Einrichtungen – Mess- und Prüfverfahren Teil 15-6: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern – Prüfung 15f: Wirksamkeit von Steckverbinder-Verriegelungen	DIN EN 60512-15-6 2009-03
Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal) Umgebungseinflüsse – Teil 2-6: Prüfverfahren – Prüfung Fc: Schwingen (sinusförmig)	DIN EN 60068-2-6 2008-10
Environmental testing – Part 2-64: Tests – Test Fh: Vibration, broadband random and guidance Umgebungseinflüsse – Teil 2-64: Prüfverfahren – Prüfung Fh: Schwingen, Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden	DIN EN 60068-2-64 2009-04
Environmental testing – Part 2-2: Tests – Test B: Dry heat Umgebungseinflüsse – Teil 2-2: Prüfverfahren – Prüfung B: Trockene Wärme	DIN EN 60068-2-2 2008-05
Environmental testing – Part 2-54: Tests – Test Ta: Solderability testing of electronic components by the wetting balance method Umweltprüfungen – Teil 2-54: Prüfungen – Prüfung Ta: Prüfung der Lötbarkeit elektronischer Bauelemente mit der Benetzungswaage	IEC 60068-2-54 2006-04
Electrical engineering - Basic environmental testing procedures - Tests; test Ca: Damp heat, steady state Elektrotechnik – Grundlegende Umweltprüfungen – Prüfungen; Prüfung Ca: Feuchte Wärme, konstant	DIN EN 60068-2-3 1986-12

3.5. Test Requirements and Procedures Summary / Anforderungen und Prüfungen

3.5.1. Characteristic Tests / Eigenschaftsprüfungen

Beschreibung	Eigenschaften	Prüfung
<p>PG 0: Inspection of as-received condition</p> <p>PG 0: Eingangsprüfung</p>	<p>Visual inspection all variants that occur</p> <p>Sichtprüfung aller vorkommenden Varianten</p>	<p>E 0.1 acc. DIN EN 60512-1-1</p> <p>E 0.1 nach DIN EN 60512-1-1</p>
<p>PG 4: Contact engagement length</p> <p>PG 4: Kontaktüberdeckung</p>	<p>Contact engagement length: >0,5 mm</p> <p>Kontaktüberdeckung: >0,5 mm</p>	<p>E 4.1 Arithmetical consideration under worst case condition</p> <p>E 4.1 Rechnerische Betrachtung unter allen ungünstigsten Bedingungen</p>
<p>PG 9 Insertion inclination / misuse sage (scoop-proofing)</p> <p>PG 9 Schrägsteckwinkel / Missbrauchssicher (Koshiri-Sicherheit)</p>	<p>Skewed insertion, that damages the contacts, is not given</p> <p>Ein Schrägsteckwinkel, der die Kontakte beschädigt, ist nicht möglich</p> <p>Examination of housing for scoop-proofing is fulfilled</p> <p>Die Missbrauchssicherheit (Koshiri-Sicherheit) ist erfüllt</p>	<p>E 9.2 Max. possible insertion inclination. Examination is performed using CAD</p> <p>Maximal möglicher Schrägsteckwinkel. Die Überprüfung wird mittels CAD durchgeführt</p> <p>E 9.3 Examination of housing for scoop-proofing. Examination is performed using CAD</p> <p>Überprüfung Gehäuse auf Koshiri-Sicherheit. Überprüfung wird mittels CAD durchgeführt</p>
<p>PG 28: Click noise of PicoMQS Receptacle Housing with PicoMQS SMD header</p> <p>PG 28: Verriegelungsgeräusch des PicoMQS Buchsengehäuses mit der PicoMQS SMD Stiftheiste</p>	<p>No minimum click noise required</p> <p>Kein Minimum Verriegelungsgeräusch</p>	<p>E 28.1, E 0.1</p> <p>E 28.1, E 0.1</p>

3.5.2. Electrical Inspections / Elektrische Prüfungen

Beschreibung	Eigenschaften	Prüfung
<p>PG 0: Insulation resistance test of PicoMQS receptacle housing with PicoMQS SMD header</p> <p>PG 0: Isolationswiderstandstest des PicoMQS Buchsengehäuses mit der PicoMQS SMD Stiftleiste</p>	<p>Insulation resistance</p> <p>Isolationswiderstand</p>	<p>E 0.3 acc. DIN EN 60512-3-1</p> <p>E 0.3 nach DIN EN 60512-3-1</p>
<p>PG 13: Housing influence on the derating</p> <p>PG 13: Gehäuseeinfluss auf das Derating</p>	<p>See derating curves figure 1- 7 (page 14-16) in addendum</p> <p>Siehe Derating-Kurven Bild 1-7 (Seite 14-16) im Anhang</p>	<p>E 13.1</p> <p>E 13.1</p>

3.5.3. Mechanical Inspections / Mechanische Prüfungen

Beschreibung	Eigenschaften	Prüfung
<p>PG 7: Reliability of the housing handling and functional</p> <p>PG 7: Handhabung und Funktionssicherheit der Gehäuse</p>	<p>Error-proof design of housings: Polarization F > 50N</p> <p>Unverwechselbarkeit der Gehäuse Polarisierungseffizienz: F > 50N</p> <p>Retention force of housing. Requirement (on the first mm):</p> <p>2-10 posn.: F>50N</p> <p>Haltekraft Gehäuse. Anforderung (auf dem ersten Weg-mm):</p> <p>2-10 pol.: F>50N</p> <p>Insertion force of the socket hsg. fully loaded. Mating: F<75N</p> <p>Steckkraft bei voll bestücktem Stecker. Stecken: F<75N</p>	<p>E 7.1 acc. DIN EN 60512-13-5</p> <p>E 7.1 nach DIN EN 60512-13-5</p> <p>E 7.2 acc. DIN EN 60512-15-6</p> <p>E 7.2 nach DIN EN 60512-15-6</p> <p>E 7.4</p> <p>E 7.4</p>

<p>Contact press-out force Kontaktausdrückkraft</p>	<p>Retention force of NanoMQS tab 0.4x0.5mm ≥ 15 N</p> <p>Retention force of Solder bracket ≥ 40 N</p> <p>Ermittlung Kontakthaltekräfte der NanoMQS Flachsteckerkontakte 0.4x0.5mm ≥ 15 N</p> <p>Ermittlung der Kontakthaltekräfte der Lötbleche ≥ 40 N</p>	<p>3 samples / housing cavity</p> <p>Test speed 25mm/min</p> <p>3 Muster / Gehäusekavität</p> <p>Testgeschwindigkeit 25mm/min</p>
<p>PG 17: Dynamic Load in unsoldered condition (without PCB)</p> <p>PG 17: Dynamische Beanspruchung in ungelötetem Zustand (ohne Leiterplatte)</p>	<p>Severity grade 2, current interruption <1000ns, contact resistance max. 7Ω.</p> <p>Schärfegrad 2, Stromunterbrechung <1000ns, Durchgangswiderstand max.7Ω</p>	<p>E 0.1 - E 14.0 acc.: DIN EN 60068-2-6, 60068-2-64</p> <p>E 0.1 - E 14.0 nach DIN EN 60068-2-6, 60068-2-64</p>

3.5.4. Environmental Inspections/ Umweltprüfungen

Beschreibung	Eigenschaften	Prüfung
<p>PG 20: Climate load of the housing without drop test of PicoMQS SMD header</p> <p>PG 20: Klimatische Beanspruchung des Gehäuses ohne Falltest der PicoMQS SMD Stiftheisten</p>	<p>Dry heat: 120h/130°C Humid heat: 10d/40°C/95%rel. humidity Cold storage: 48h/-40°C Dry heat 48h/80°C</p> <p>Trockene Wärme 120h/130°C Feuchte Wärme 10d/40°C/95%rel. Feuchtigkeit Kältelagerung 48h/-40°C Trockene Wärme 48h/80°C</p>	<p>E 0.1 - E 0.3 B 20.1, B 20.2, B 20.3, B 20.4, B 20.5</p> <p>E 0.1 - E 0.3 B 20.1, B 20.2, B 20.3, B 20.4, B 20.5</p>
<p>PG 21: Long-term temperature aging without drop test of PicoMQS SMD header</p> <p>PG 21: Langzeittemperaturlagerung ohne Falltest der PicoMQS SMD Stiftheisten</p>	<p>Dry heat: 1000h/130°C</p> <p>Trockene Wärme 1000h/130°C</p>	<p>E 0.1, E 0.2 B 21.1, E 21.1</p> <p>E 0.1, E 0.2 B 21.1, E 21.1</p>

<p>PG 22A: Chemical resistance PG 22A: Chemische Beständigkeit</p>	<p>Test samples get loaded with testing media and are stored for 48h under testing temperature</p> <p>Only dimensional check of rec. housing</p> <p>Prüflinge werden mit Prüfmedien beaufschlagt und 48h bei Prüftemperatur gelagert</p> <p>Nur Maße der Buchsengehäuse geprüft</p>	<p>E 0.1, E 0.3 B 22.1 A</p> <p>E 0.1, E 0.3 B 22.1 A</p>
<p>Solderability Test and Heat resistance of the component Lötbarkeitstest und Wärmebeständigkeit der Komponente</p>	<p>Visual inspection</p> <p>Dry heat 155°C/16h</p> <p>Solderability test</p> <p>High humidity / high temperature 85°C/85% r.H./168h</p> <p>Heat resistance of the component to lead-free reflow soldering (in reference to JEDEC J-STD-20D)</p> <p>Sichtprüfung</p> <p>Trockene Hitze 155°C/16h</p> <p>Lötbarkeitstest</p> <p>Hohe Luftfeuchtigkeit / hohe Temperatur 85°C/85% r.H./168h</p> <p>Wärmebeständigkeit der Komponente gegen bleifreies Reflow-Löten (in Anlehnung an die JEDEC J-STD-020D)</p>	<p>DIN EN 60512-1-1</p> <p>DIN EN 60068-2-2, Bb</p> <p>IEC 60068-2-54</p> <p>DIN EN 60068-2-3, Ca</p> <p>Solderability test acc. TEC-109-201, test method A, cond. B</p> <p>DIN EN 60512-1-1</p> <p>DIN EN 60068-2-2, Bb</p> <p>IEC 60068-2-54</p> <p>DIN EN 60068-2-3, Ca</p> <p>Lötbarkeitstest gemäß TEC-109-201, Testmethode A, Kond. B</p>

3.6. Qualification and Requalification Tests of PicoMQS contacts /

Qualifikations- und Re-Qualifikationsprüfungen der PicoMQS Kontakte

Test sequence for electrical, mechanical and environmental test of PicoMQS contacts are described in the specification 108-94545.

Die Testabläufe für elektrische-, mechanische- und Umweltprüfungen der einzelnen PicoMQS Kontakte wie z.B.: Vibration und Schockprüfung, sind in der Spezifikation 108-94545 beschrieben.

4. QUALITY ASSURANCE PROVISIONS / QUALITÄTSSICHERUNGSMASSNAHMEN

4.1. Qualification Testing /

Qualifikationsprüfung

a. Sample Selection / Auswahl der Prüflinge

Test samples shall be prepared in accordance with product drawings. They shall be selected at random from current production.

Test groups prepared according to LV 214 (MBN 10384 2010-11; VW 75174 2010-04; GS 95006-7-1 2010-05).

Die Prüflinge müssen den Zeichnungsunterlagen entsprechen. Sie sind der laufenden Produktion zufällig zu entnehmen.

Die Prüfgruppen sind gemäß LV 214 (MBN 10384 2010-11; VW 75174 2010-04; GS 95006-7-1 2010-05) vorzubereiten.

b. Test Sequence / Prüfgruppen

Qualification inspection must be verified by testing samples as specified in Para. 3.5.

Die Prüfungen müssen gemäß den unter Abs. 3.5 aufgeführten Prüfgruppen durchgeführt werden.

4.2. Requalification Testing /

Re-Qualifikationsprüfung

If changes significantly affecting form, fit or function are made to the product or to the manufacturing process, product assurance shall coordinate requalification testing, consisting of all or part of the original testing sequence as determined by development/product, quality and reliability engineering.

Falls signifikante, die vereinbarten Eigenschaften berührende Änderungen der Form, Ausstattung oder Funktion des Produktes oder dessen Herstellungsverfahrens vorgenommen wurden, wird die zuständige Entwicklungsabteilung einen Requalifikationstest koordinieren. Dieser besteht aus einem Teil oder den gesamten ursprünglichen Prüfungen, je nach Festlegung durch die Entwicklungs- und Qualitätssicherungsabteilung.

4.3. Acceptance / Abnahme

Acceptance is based on verification that the product meets the requirements of Para. 3.5. Failures attributed to equipment, test setup or operator deficiencies shall not disqualify the product. When product failure occurs, corrective action shall be undertaken and samples resubmitted for qualification. Testing to confirm corrective action is required before re-submittal.

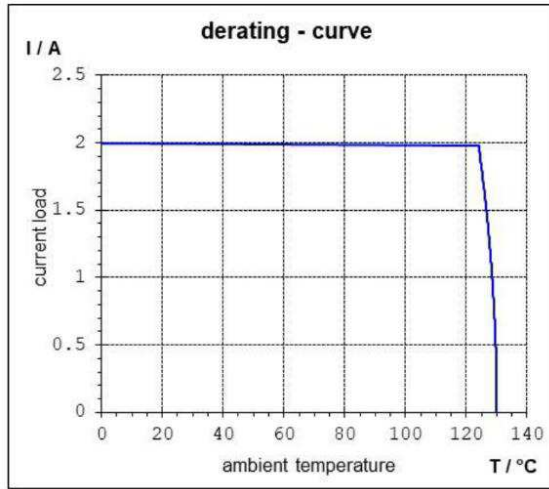
Die Abnahme basiert auf dem Nachweis, dass das Produkt den Anforderungen nach Abschnitt 3.5 genügt. Abweichungen, die auf Messgeräte, Messanordnungen oder Bedienungsängel zurückzuführen sind, dürfen nicht zum Entzug der Qualifikation führen. Tritt eine Abweichung auf, müssen korrigierende Maßnahmen ergriffen werden und die Qualifikation ist erneut nachzuweisen. Vor dieser Requalifikation ist durch entsprechende Prüfungen der Erfolg der Korrekturmaßnahme zu bestätigen.

4.4. Quality Conformance Inspection / Prüfung der Qualitätskonformität

The applicable TE quality inspection plan will specify the sampling acceptable quality level to be used. Dimensional and functional requirements shall be in accordance with the applicable product drawing and this specification.

Die Konformitätsprüfung erfolgt nach dem zugehörigen Qualitätsinspektionsplan, der die annehmbare Qualitätsgrenzlage nach dem Stichprobenumfang festlegt. Maßliche und funktionelle Anforderungen müssen mit den Produktzeichnungen und dieser Spezifikation übereinstimmen.

5. Addendum / Anhang



PicoMQS: 2-2287720-1 Rev.B
Material: CuNi3SiMg / Sn
Wire: 0.22mm² / FLU7Y-A

Tab 0.5x0.4 header hsg.: 2304171-4 Rev.A
Material: PA4T-GF30

2pos. PicoMQS rec. hsg.: 1-2332182-1 Rev. A
Material: PBT-GF 10
2pos. Tab 0.5x0.4, header assy.: 2339202-2 Rev. A
Material: Cu-Alloy / Tin

Figure 1 Derating curve 2pos

PicoMQS: 2-2287720-1 Rev.B
Material: CuNi3SiMg / Sn
Wire: 0.22mm² / FLU7Y-A

Tab 0.5x0.4 header hsg.: 2304171-5 Rev. A
Material: PA4T-GF30

3pos. PicoMQS rec. hsg.: 1-2332183-1 Rev. A
Material: PBT-GF 10
3pos. Tab 0.5x0.4, header assy.: 2339203-3 Rev. A
Material: Cu-Alloy / Tin

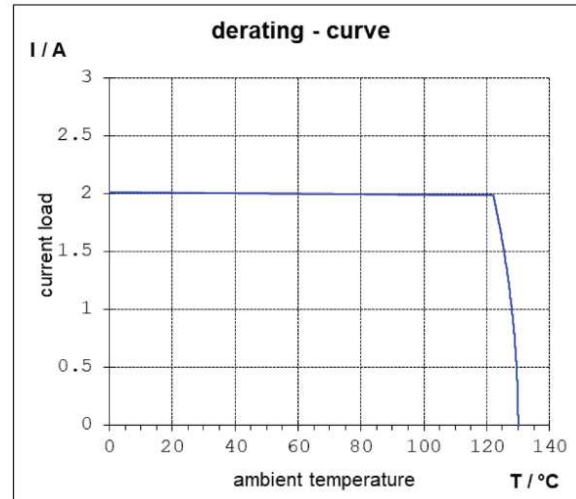
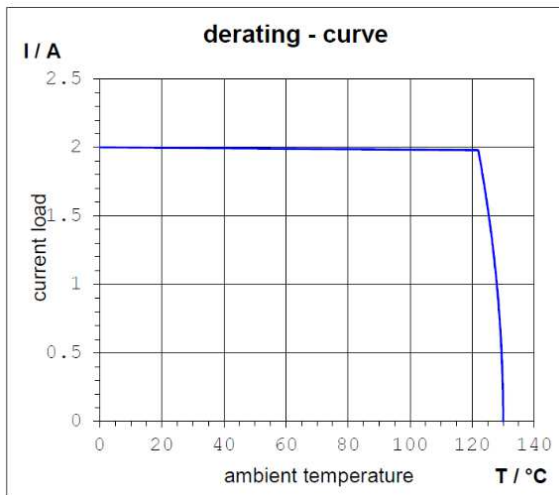


Figure 2 Derating curve 3pos



PicoMQS: 2-2287720-1 Rev.B
Material: CuNi3SiMg / Sn
Wire: 0.22mm² / FLU7Y-A

Tab 0.5x0.4 header hsg.: 2304171-6 Rev. A
Material: PA4T-GF30

4pos. PicoMQS rec. hsg.: 1-2332184-1 Rev. A
Material: PBT-GF 10
4pos. Tab 0.5x0.4, header assy.: 2339204-4 Rev. A
Pin Material: Cu-Alloy/ Tin

Figure 3 Derating curve 4pos

PicoMQS: 2-2287720-1 Rev.B
 Material: CuNi3SiMg / Sn
 Wire: 0.22mm² / FLU7Y-A

Tab 0.5x0.4 header hsg.: 2304171-6 Rev. A
 Material: PA4T-GF30

9pos. PicoMQS rec. hsg.: 1-2332189-1 Rev. A
 Material: PBT-GF 10

9pos. tab0.5x0.4, header assy.: 2339209-9 Rev. A
 Material: Cu-Alloy / Tin

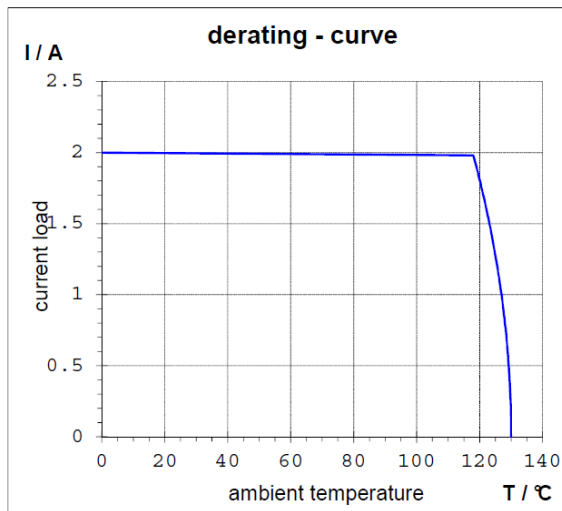
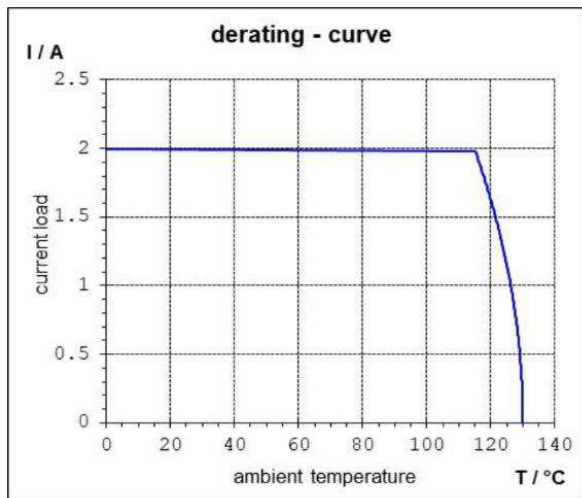


Figure 4 Derating curve 9pos



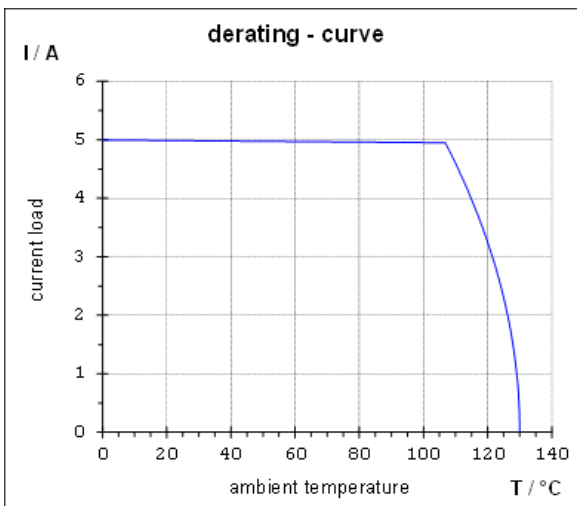
PicoMQS: 2-2287720-1 Rev.B
 Material: CuNi3SiMg / Sn
 Wire: 0.22mm² / FLU7Y-A

Tab 0.5x0.4 header hsg.: 2304171-9 Rev. A
 Material: PA4T-GF30

10pos. PicoMQS rec. hsg.: 1-2332190-1 Rev. A

Material: PBT-GF 10
 10pos. T ab0.5x0.4, header assy.: 1-2339210-0 Rev. A
 Material: Cu-Alloy / Tin

Figure 5 Derating curve 10pos



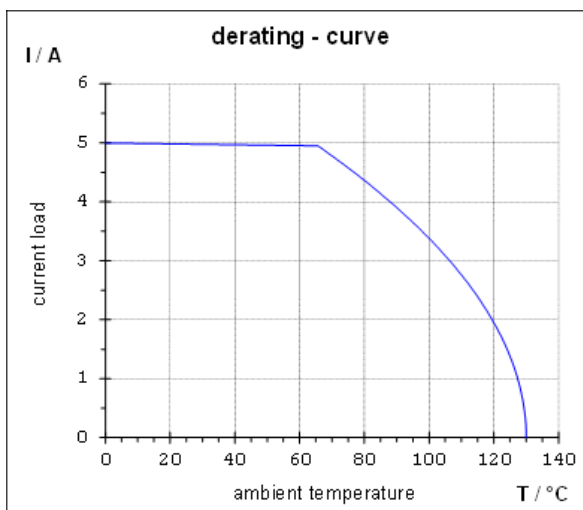
PicoMQS: 2-2287720-1 Rev.B
 Material: CuNi3SiMg / Sn
 Wire: 0.22mm² / FLU7Y-A

Tab 0.5x0.4 header hsg.: 2304171-4 Rev. A
 Material: PA4T-GF30

2pos. PicoMQS rec. hsg.: 1-2332182-1 Rev. A
 Material: PBT-GF 10

2pos. Tab 0.5x0.4, header assy.: 2339202-2 Rev. A
 Material: Cu-Alloy / Tin

Figure 6 Derating curve 2pos



PicoMQS: 2-2287720-1 Rev.B
 Material: CuNi3SiMg / Sn
 Wire: 0.22mm² / FLU7Y-A

Tab 0.5x0.4 header hsg. 2304171-9 Rev. A
 Material: PA4T-GF30

10pos. PicoMQS rec. hsg.: 1-2332190-1 Rev. A
 Material: PBT-GF 10

10pos. Tab 0.5x0.4, header assy.: 1-2339210-0 Rev. A
 Material: Cu-Alloy / Tin

Figure 7 Derating curve 10pos

<u>REV</u>	<u>REVISION RECORD</u>	<u>DWN</u>	<u>APP</u>	<u>DATE</u>
A	New product specification created	S. Gilch	S. Krauss D. Nagel	05.AUG2022
B	Redefine of max. Current carrying Derating curve figure 6 and 7 added	S. Gilch	S. Krauss D. Nagel	18AUG2023